

# AMD se tournerait vers TSMC pour les APU Kabini et Temash

Les futurs APU (*Accelerated Processing Unit*) à faible et très faible consommation d'AMD devraient être gravés par TSMC pour une livraison au premier semestre 2013 si l'on en croit [extremetech](#) qui aurait recueilli cette information lors du CES.

Le moins que l'on puisse dire c'est que le torchon brûle entre AMD et GlobalFoundries (GF). Même si cette dernière était une co-entreprise formée en 2009 par AMD et Advanced Technology Investment Company (ATIC), les relations se sont détériorées ces dernières années entre AMD et GF. La faute à des retards de livraison qu'AMD impute à GF. Suite à différents problèmes, AMD a annulé les APU Wichita et Krishna. Mais jusqu'à présent, la société n'avait pas dévoilé officiellement le nom du fondeur qui gravera ses futurs SoC.

AMD avait par ailleurs pris ses distances avec GF en abandonnant sa participation minoritaire de 10% sur la fonderie de semi-conducteurs en mars 2012. La rupture s'est confirmée après qu'AMD ait dû payer des centaines de millions de dollars à GF pour cause de rupture de contrat.

Selon toute vraisemblance, les **APU Kabini et Temash** devraient donc être gravés dans la **technologie 28 nm** du fondeur taïwanais **TSMC**.

L'APU **Tesdash** décliné en dual et quad coeur sera le **second SoC AMD pour tablettes. 100% plus rapide que le Z60**, il viendra concurrencer le prochain Atom quad coeur de nouvelle génération d'Intel. A l'instar de l'APU Kabini, il devrait être **disponible au second trimestre 2013**.

Les **APU Kabini** déclinés en dual et quad coeur prendront le relais des A4 et A6 et équiperont des notebooks à très faible consommation. Ils seront **50% plus performants que les APU Brazos**.

Si AMD s'est tourné vers TSMC pour assurer le *time-to-market* des Kabini et Temash, les liens ne se seraient toutefois pas irrémédiablement distendus avec son ancienne fonderie.

# AMD 2013 Client Roadmap

<b>Performance</b>	<p>AMD 2<sup>nd</sup> Generation A-Series APU's codename "Trinity"</p>	<p>AMD 2<sup>nd</sup> Generation A-Series APU's codename "Richland"</p> <p>Desktop, Standard notebook (35W) and Low Voltage (17-25W)</p> <p>2-4 "Piledriver" CPU cores</p> <p>2<sup>nd</sup> Generation DirectX®11 GPU</p>	<p>"Kaveri" 3<sup>rd</sup> Gen A-Series APU's</p> <p>2-4 "Steamroller" CPU Cores</p> <p>Graphics Core Next (GCN) GPU</p> <p>HSA Application Support</p>
<b>Mainstream</b>			
<b>Low-Power Essential</b>	<p>AMD C-Series and E-Series APU's codename "Brazos 2.0"</p> <p>Low Voltage (9-18W)</p> <p>2 "Bobcat" CPU Cores</p> <p>DirectX®11 capable GPU</p>		<p>"Kabini" A-Series and E-Series APU's</p> <p>Complete SoC</p> <p>Low Voltage (9-15W)</p> <p>2-4 "Jaguar" CPU cores</p> <p>Graphics Core Next (GCN) GPU</p>
<b>Ultra-Low Power Tablet/Fanless</b>	<p>AMD Z-Series APU codename "Hondo"</p> <p>1-2 "Bobcat" CPU Cores, Ultra Low Voltage (4.5W), DirectX®11 capable GPU</p>		<p>"Temash" A-Series Elite Mobility APU's</p> <p>Ultra Low Voltage; Complete SoC; 2-4 "Jaguar" CPU Cores</p> <p>Graphics Core Next (GCN) GPU</p>

AMD roadmaps are subject to change without notice

40nm 32nm 28nm